

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa zamawiającego: Semicon sp. z o.o.

Termin składania ofert: 26.06.2017

Numer zgłoszenia w bazie Zamawiającego: 2017/06/14/01/PL

Status ogłoszenia: otwarte

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Oferty należy złożyć do dnia 26.06.2017 do godz. 12:00 w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Zwoleńska 43/43A, 04-761, Warszawa
2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: adres Wykonawcy, adres Zamawiającego, dopisek „Oferta na świadczenie usług badawczo-rozwojowych. Nie otwierać do dnia 26.06.2017 do godz. 12:30”
3. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone w inny sposób, w tym drogą elektroniczną zostaną odrzucone.
4. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty, które spłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Pan Piotr Ciszewski, Semicon sp. z o.o., adres email: pciszewski@semicon.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

+48 605 745 270

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo – rozwojowe polegające na opracowaniu, zaprojektowaniu i zbadaniu właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych zespołów elektronicznych wykonanych w technologii FLEX dla aplikacji krytycznych z sektora wojskowego, które są planowane do realizacji w ramach przygotowywanego przez Zamawiającego projektu badawczego na konkurs 1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka MŚP, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekt będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zakres prac obejmuje realizację 7 etapów:

Etap 1

Analiza i opracowanie założeń do projektu zespołu elektroniki uwzględniającego różne parametry materiałów na laminaty typu FLEX spełniające restrykcyjne wymagania aplikacji krytycznych z sektora wojskowego.

Etap 2

Analiza i opracowanie założeń do projektu zespołu elektroniki uwzględniającego różne parametry elementów elektronicznych spełniające restrykcyjne wymagania aplikacji krytycznych z sektora wojskowego.

Etap 3

Projekt funkcjonalnego zespołu elektroniki uwzględniającego analizę i założenia z etapów 1 i 2 dla jednej z opracowywanych technologii: FLEX, RIGID-FLEX lub SEMI-FLEX.

Etap 4

Opracowanie dokumentacji technologicznej, specyfikacji technicznej i niezbędnego oprogramowania dla zespołu elektroniki.

Etap 5

Uruchomienie opracowanego zespołu elektroniki do dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Etap 6

Badania właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych opracowanego zespołu elektroniki.

Badania powinny być wykonane na specjalnych stanowiskach. Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami dla sektora wojskowego.

Etap 7

Sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań i określenie warunków odbioru technicznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo Mazowieckie, Powiat Warszawski, Gmina Warszawa Wawer,
Miejscowość: Warszawa